

令和4年10月27日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
定例講演会
会長 嶋田 勇三

第217回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第217回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。今回も新型コロナウイルス感染症対策のため、WEB会議システム（zoom ウェビナー）を利用した開催となります。会場開催での定例講演会と申込内容や開催形式が異なりますので、ご確認いただけますようお願いいたします。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和4年11月17日（木）定例講演会 13：20～16：45

2. 開催方式：WEB会議システム「zoom ウェビナー」
（参加申し込みをされた方に後日、招待メールをお送りします）

3. プログラム：“最近の実装トピックス”

13:20～14:20 プログラムテーマ①	『ナノインプリントを応用した微細配線形成の試み』 北海道科学大学工学部 機械工学科 教授 見山 克己 氏 講演内容：プリント配線板の高密度化について、現状のフォトリソグラフィベース製造技術では配線幅 3 μ m 程度が限界と予想されている。一方、半導体の実装端子がますます狭ピッチ化する中、これに対応するサブストレートには配線幅 1 μ m クラスの実現が求められる。これには現状の製造技術では限界があるため、ナノインプリントを応用した微細配線形成に取り組んでおり、その概要について紹介する。あわせて、次世代 6G 通信を見据えた高周波用途への対応について考察する。
14:20～15:20 プログラムテーマ②	『シリコンキャパシタの最新技術動向』 (株) 村田製作所 コンポーネント事業本部 パッシブデバイス事業部 新規商品部 部長 近重 康彦 氏 講演内容：様々な電子機器において大容量通信・高速通信が進む中、各種回路で使用されるコンデンサも変化している。特に先端の電子機器に於いては、超薄型、低 ESL、低 ESR、高温保証、ミリ波帯における低挿入損失など、コンデンサに対して新しいニーズが顕在化し伸張する中で、シリコンキャパシタの需要が拡大している。本講演では、シリコンキャパシタの特徴を説明した上で、特に通信端末プロセッサにおけるシリコンキャパシタのニーズについて詳しく紹介する。
15:20～15:35	－ 休 憩 －
15:35～16:35 プログラムテーマ③	『最新の半導体と実装技術、ますます深い関係に』 国際技術ジャーナリスト津田 建二 氏 講演内容：最新の半導体技術では、配線幅・間隔の進化はすでに止まっている。7nm や 5nm といってもチップ上のどこにもそのような配線幅も間隔もない。配線幅のリニアスケールから面積スケールへと移行しているからだ。TSMC や Samsung など先端半導体技術が DTCO と呼ばれる面積スケールへと移っており、もはや 2nm、1.4nm 以下は見えない。そこで両社とも先端パッケージ技術へと手を広げている。半導体と実装技術はますます接近していく。
16:35～16:45	『トークセッション』 講師の皆様と参加者の皆様とで、意見交換を行う時間を設けます。

4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。

会員外：22,000円/人（お申し込み後、請求書をお送りします）

5. **参加申し込み**：会員のご出欠については、会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

会員外の方は、ホームページのお問い合わせフォーム

（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に第217回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和4年11月9日（水）

会員外 令和4年11月4日（金）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日1週間前に郵便で発送させていただきます（企業正会員は登録代表者（連絡担当者）にお送りします）。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田
携帯：090-5403-1147（相良）、090-5301-9467（太田）
E-mail: j.jisso.org@gmail.com
URL: <http://www.j-jisso.org/index.html>